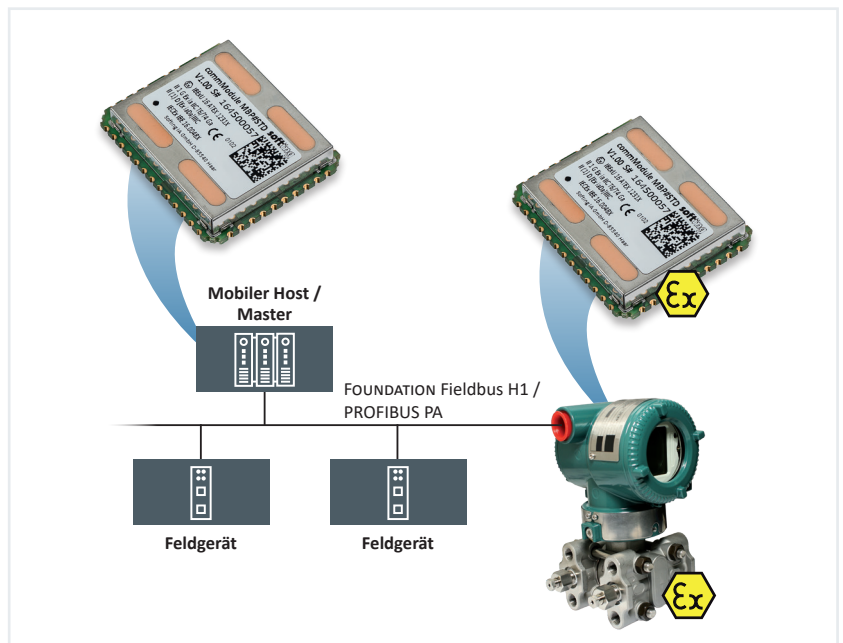
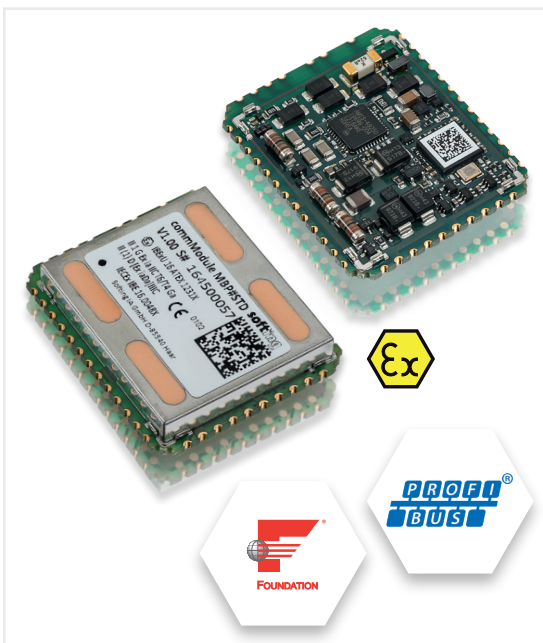


commModule MBP

Implementierung von FOUNDATION Fieldbus- und PROFIBUS PA-Feldgeräten

- Schnelle und kostengünstige Feldbus-Implementierung mit einer einzigen Hardware-Plattform für FOUNDATION Fieldbus H1- und PROFIBUS PA-Geräte
- Einfache Integration in HART- und Modbus-Geräte durch skriptgesteuerte Zuordnung zu HART- oder Modbus-Befehlen mit dem commScripter-Werkzeug.
- Kompakte Bauweise sowie die universelle Hardware sind entscheidende Argumente zugunsten des commModule MBP



Schnelle Implementierung

- Schneller Implementierungspfad zu FOUNDATION Fieldbus H1- bzw. PROFIBUS PA-Geräten
- Vollständig getesteter Protokoll-Stack, erprobt in zehntausenden von Feldgeräten
- Nur die Hardware-Integration ist zu implementieren
- Erfüllung der FF-Anforderungen für Physical Layer-Test und Konformitätsbewertung sowie der PA-Spezifikationen

Intelligente Art, HART- und Modbus-Geräte für Feldbus und PROFIBUS zu upgraden

- Skriptgesteuerte Zuordnung der Feldbus-Funktionsblockanwendung zu gerätespezifischen HART- oder Modbus-Befehlen
- Keine C-Programmierung erforderlich
- commScripter-Werkzeug prüft Skript und erstellt Mapping-Tabelle
- Standardmäßige commModule werden durch Herunterladen der Mapping-Tabelle angepasst

Kostenreduzierung durch Universelle Huckepack-Lösung

- Kompakte Bauweise für den Einsatz in den meisten Prozessausrüstungen
- Keine teure Entwicklung von Feldbus-Hardware
- Keine Stapelportierung, keine Anwendungsprogrammierung
- Komponenten nur einseitig platziert, automatische Montage auf dem Motherboard möglich
- Vergossene und nicht vergossene Version für optimiertes Ex-Design
- ATEX- und IECEx-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebungen
- Stack-Lizenz inklusive, FF- oder PA-Funktionalität über Hardware-Pin ausgewählt

commModule MBP

Technische Daten

Hardware	Prozessor	Renesas RX64M
	RAM	512 kByte
	Flash	3 MByte (On-Chip)
	Nichtflüchtiger RAM	On-Chip zur dauerhaften Speicherung der Parameter
	Verbindungsstecker	Löt pads am Rand der Leiterplatte
	Stromverbrauch	10 mA ... 26 mA (per Software einstellbar)
	Spannungsversorgung zum Gerät	3,2 V (max. 70 mW) und 6,2 V (max. 90 mW)
	Betriebstemperatur	-40 °C ... +80 °C
	Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	10 %... 90 % nicht kondensierend
	Montage	Löten (automatische Montage bei nicht vergossener Version möglich)
	Gewicht	15 g (vergossen), 8 g (nicht vergossen)
	Abmessungen	32,00 x 38,71 x 6,50 mm
Schnittstellen	Feldbus-Schnittstelle	FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA nach IEC61158-2, wählbar über HW-Pin
	Schnittstelle zum Feldgerät	UART (normale Firmware für commScripter), UART, I2C, SPI (benutzerspezifische Firmware)
	Protokoll zum Feldgerät	Protokoll zum Feldgerät
Zertifizierungen	ATEX	II 1G Ex ia IIC Ga
	IBEXU17ATEX1135U	II (1)D [Ex ia Da] IIIC
	IECEX IBE 17.0038U	Ex ia IIC Ga, [Ex ia Da] IIIC
	FF-Physikalische Schicht	Bestanden
	FF-Konformität	Bestanden (CT1014FF)

Lieferumfang

Hardware	Verpackungseinheit: 90 Stück im Tray (versiegelte Trockenverpackung)
Firmware	FF- und PA-Gerätetack sowie commKit-Mapping-Anwendung sind auf dem Board geflasht
Dokumentation	Hardware-Benutzerhandbuch

Bestellnummern

EIA-KS-022200	commModule MBP vergossen, 90 Stück im Tray
EIA-KS-022220	commModule MBP nicht vergossen, 90 Stück im Tray
EIA-KS-022400	commModule MBP vergossen, 5 Proben im Tray, vergossen
EIA-KS-022420	commModule MBP nicht vergossen, 5 Proben im Tray

Ergänzende Produkte und Dienstleistungen

EVA-MK-022210	commModule Evaluation Kit (commModule MBP im Gehäuse mit Anschlüssen)
DXA-KL-020620	Renesas E1 Flasher
LDA-KM-022451	commScripter Einzelplatz-Entwicklerlizenz FF zu HART
LDA-LM-022452	commScripter Einzelplatz-Entwicklerlizenz PA zu HART
LDA-KS-022453	commScripter Einzelplatz-Entwicklerlizenz FF zu Modbus
LDA-LS-022454	commScripter Einzelplatz-Entwicklerlizenz PA zu Modbus
HUA-AA-001012	USB-Hardlock für commScripter-Lizenzen
SIA-KS-022470	commScripter-Workshop (pro Tag)
SIA-KL-020100	Integrations-Unterstützung (pro Stunde)

Ihr lokaler Kontakt zu Softing:

<https://industrial.softing.com>

optimize!
softing